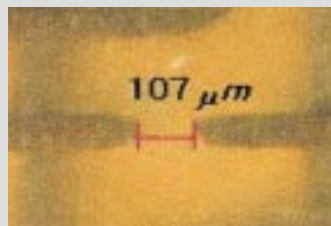


【原因、判断要点、发生工序】由于 DFR 和 AWF 之间夹杂的箔片或剥离片状的不透明杂物，妨碍内层线路的曝光所引起（内层曝光～内层 ET）的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The open is caused by the block of exposure light for the inner layer conductor formation by a thin and opaque foreign object included between dry film and a phototool. (Internal layer exposure - internal layer etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-1-2 ダメージ起因（断線）／损坏起因（开路） / Caused by damages to the board(Electrical open)

1-1-2-1 変形切断断線／变形而切断的开路 / Deformed and broken

【特徴】 回路線が引き伸ばされた状態で切れている断線。接触痕やソルダレジスト剥離を伴っていることが多い

【特征】 线路被拉伸然后断开的开路，多数同时发生碰撞痕迹和 SR 剥落。

【Characteristics】 The conductor is stretched to break and often accompanied with contact marks or peeled solder resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】 回路線形成後に何かが当たったために出来たもの。ソルダレジスト塗布前後の衝突区分により、ソルダレジストの損傷の有無が分かれる（回路形成後）

【原因、判断要点、发生工序】 线路形成后碰撞而发生的。通过 SR 涂布前后的碰撞区分，可以弄清楚 SR 损伤与否（线路形成后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Conductor pattern is hit by some foreign object after the conductor pattern is formed. Damage to the solder resist may or may not occur depending on whether the damage is made before or after the solder resist application. (After conductor pattern formation)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 10

【注釋】
显微镜倍率 × 10

【Comments】
Magnification: ×10



【コメント】
顕微鏡倍率 × 20

【注釋】
显微镜倍率 × 20

【Comments】
Magnification: ×20



【コメント】
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50



【コメント】
顕微鏡倍率 × 10

【注釋】
显微镜倍率 × 10

【Comments】
Magnification: ×10